

**华润微电子有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

(2024年1月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研    <input type="checkbox"/>分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访        <input type="checkbox"/>业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会      <input checked="" type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>1月10日 9:00-10:00, 10:30-11:30, 13:00-14:00, 15:00-16:00, 16:30-17:30</p> <p>OPEN DOOR Investment、新华资产、天弘基金、荷兰汇盈资产、Avanda Investment、山西证券、富国基金、国泰基金、爱建证券</p> <p>01月17日 10:30-11:30, 13:00-14:00, 15:00-16:00</p> <p>广发证券, 中邮证券, 汇添富基金、太平资产、中欧基金</p> <p>01月25日 09:00-10:00, 10:30-11:30, 15:00-16:00</p> <p>申银万国证券、华能贵诚信托、宁涌富基金、工银安盛人寿、上海证券、兴银基金、笙华私募、世纪证券、国联基金、信泰人寿、西藏东财基金、神旺投资、深高投资、Goldennest Capital、杭银理财、中航信托、华安资管、山西证券资产管理、蜂巢基金、弘尚资产、创金合信基金、长盛基金、富国基金、浙商证券、东方基金、Newton Investment</p>
<p>时间</p>	<p>01月10日 9:00-10:00, 10:30-11:30, 13:00-14:00, 15:00-16:00, 16:30-17:30</p>

	<p>01月17日 10:30-11:30, 13:00-14:00, 15:00-16:00</p> <p>01月25日 09:00-10:00, 10:30-11:30, 15:00-16:00</p>
地点	上海、无锡
上市公司接待人员姓名	<p>吴国屹 华润微电子执行董事、财务总监兼董秘</p> <p>沈筛英 华润微电子董事会办公室副主任</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题一：请公司对功率半导体行业做一个整体的周期判断，可见的订单中是否有复苏迹象？</b></p> <p>答：从2022年5月份包括2023年全年均为半导体下行调整周期，在经历了长时间的低迷后，当前产业趋势已逐步稳定，在某些细分领域已有订单增加，恢复过程相对平缓，不是“V”型反转，预计“L”型会持续一段时间。</p> <p><b>问题二：请描述下公司的战略布局情况？</b></p> <p>答：公司坚持“长三角+成渝双城+大湾区”两江三地全国性业务布局。长三角指无锡和上海，其中无锡有三条6吋产线，一条8吋产线，上海是控股型总部，主要是设计服务、市场与销售中心以及应用技术研究中心；成渝双城主要指重庆，有一条8吋产线、一条12吋产线以及先进封测基地，聚焦高端工控及汽车电子市场，打造车规级功率半导体产业基地和汽车芯片产业生态圈；粤港澳大湾区主要布局深圳，设有南方总部暨全球创新中心以及一条12吋特色功率集成电路生产线。</p> <p><b>问题三：请问如何展望2024年市场景气度？</b></p> <p>答：2024年各机构预测全球半导体市场将会实现两位数增长，其中WSTS预测增长13.1%，Gartner预测增长16%，IBS预测增长12%，从各项预测数据来看，2024年全球半导体增长趋势确定性较强。</p>

**问题四：请问公司产品价格趋势？**

答：不同产品、不同细分市场和应用领域价格表现有所差异，总体来看，公司目前产品价格基本企稳。

**问题五：请问公司 IDM 和代工两块业务的占比情况如何？公司对未来的收入结构是如何规划的？**

答：公司目前 IDM 及代工业务在营收中各占 50%。公司致力于向综合一体化产品公司转型，产品发展速度会快于代工。产品方面我们会给予更多资源倾斜，另一方面收购兼并业务也会重点放在产品方面。

**问题六：请问公司投资并购的主要方向？**

答：公司围绕功率半导体、传感器、智能控制三大产品领域寻找合适的投资标的，以此丰富公司产品系列、补齐公司产品链。

**问题七：请问目前公司晶圆制造产能利用率如何？**

答：公司受益于 BCD 特色工艺优势、客户基础稳定以及 IDM 商业模式调节等因素，公司目前 8 吋产能利用率保持在 90%以上，6 吋保持在 95%以上。

**问题八：请问公司晶圆制造产能利用率始终保持较高水平的原因？**

答：主要得益于三个方面，一是公司 BCD 等特色工艺具有稀缺性优势；二是代工客户质量高、粘度高，很多重要客户均有定制化工艺开发，客户关系稳定；三是公司 IDM 模式具有调节弹性。

**问题九：请问公司如何保持 IGBT 的高速增长？**

答：产品规划上，一是从 6 吋产线升级到 8 吋产线，并进一步加大 12 吋 IGBT 工艺技术和产品研发投入；二是 IGBT 模块产品规模上量，模块占比不断增加；三是加大 IGBT 产品在工控和汽车电子方面的应用。

**问题十：请问公司碳化硅产品的具体进展？**

答：公司碳化硅二极管和碳化硅 MOS 均已稳定量产，主要应用是汽车电子、充电桩、光伏储能、工业电源等，二极管和 MOS 产品均有进入汽车电子应用。

**问题十一：请问公司如何展望碳化硅未来的发展空间？**

答：碳化硅市场目前正处于成长期，近 5 年年复合增长率超过 20%，一是碳化硅主要的应用市场如新能源汽车、充电桩、光伏、储能等行业正处于快速发展期，二是碳化硅功率器件由于其高压高温高频特性，在很多应用领域在逐步替代硅基产品的市场份额，比如空压机、UPS、射频电源等。

**问题十二：请问公司氮化镓产品的具体进展？**

答：公司氮化镓产品同时发展 E-MODE 和 D-MODE 技术路线，目前，D-MODE 产品已经实现量产，各方面性能直接对标国际品牌；E-MODE 产品目前已经有头部企业合作项目。

**问题十三：请问公司目前库存情况？**

答：公司目前在制品和产成品的库存在 2 个月左右，处于合理安全范围。

**问题十四：请问公司模块产品的进展？**

	<p>答：公司模块产品包括 TMBS 模块、IPM 模块、IGBT 模块、MOS 模块，2024 年将会实现较快增长并带来显著业绩贡献。</p> <p><b>问题十五：请问公司重庆封测基地有哪些封装工艺？</b></p> <p>答：公司在重庆建设的先进功率半导体封测基地已实现模块级先进封装、晶圆级先进封装、功率器件框架级封装、面板级先进封装的全面布局覆盖。</p> <p><b>问题十六：请问公司功率 IC 主要有哪些产品？</b></p> <p>答：公司功率 IC 主要包括 LED 驱动、电源、电机驱动、功放电路、BMS、AC-DC、DC-DC、无线充等。</p> <p><b>问题十七：请问公司掩膜业务的进展？</b></p> <p>答：公司掩膜业务目前产能 3000 片/月，已服务国内各主要 FAB 线及众多 IC 设计公司。高端掩膜项目预计在二季度实现量产，规划产能 1000 片/月，可提供 40nm 及以上线宽的掩膜代工服务。目前公司掩膜业务在国内本土掩膜制造企业排名第一，是国内最大的开放式、技术和产能领先的掩膜工厂。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 1 月